

Features

- ▶ AIワイヤーボンディング
- ▶ プローブテストからファイナルテスト/パッキングまでのフルターンキーソリューション
- ▶ 環境に優しい材料：Pbフリーめっきおよびハロゲンフリーモールド樹脂
- ▶ リード先端下部めっき厚：リード厚の50%以上

Under Development

- ▶ 環境に配慮したPbフリーはんだダイアタッチ

Process Highlights

- ▶ インターコネクト：
φ125 μm ~ φ300 μm AIワイヤ
- ▶ めっき：100%無光沢Sn
- ▶ マーキング：レーザーマーク

HSON8

HSON8 は、SOP8パッケージと同一のフットプリント (5 x 6 mm) を採用しています。HSON8は熱特性を強化するため露出したダイパッドを備えています。

Applications

HSON8は低オン抵抗と高速スイッチングMOSFET向けに設計され、ミディアムパワー（基準値 80W*/60A）に適しています：

- ▶ モータードライバ
- ▶ インジェクションドライバ
- ▶ 電源回路
- ▶ ランプドライバ
- ▶ 自動車向け製品

*Tc = 25°C, Tj = Max 150°C

Reliability Qualification

J-Devicesのパッケージは実績のある信頼性の高い部材で製造されています。

- ▶ 前処理条件：JEDEC標準（HTSを除く）
- ▶ 85°C/85% RH, 168 hours, IR reflow 260°C 3X
- ▶ PCT：121°C/100% RH/2 atm, 96 hours
- ▶ 温度サイクル：-55°C/+150°C, 300 cycles
- ▶ 高温保管（HTS）：150°C, 1000 hours

Test Service

J-DevicesはMOSFET、インテリジェントパワーデバイスなどの様々なパワーディスクリートのテストを含むフルターンキーソリューションを提供いたします。

- ▶ パワーディスクリートテスト：
 - ▷ DC
 - ▷ キャパシタンス *1
 - ▷ Rg *1
 - ▷ アバランシェ試験
 - ▷ 熱抵抗
- ▶ プログラムコンバージョン
- ▶ 電氣的不良解析
- ▶ マーキング、外観検査、テープ&リール 一体機

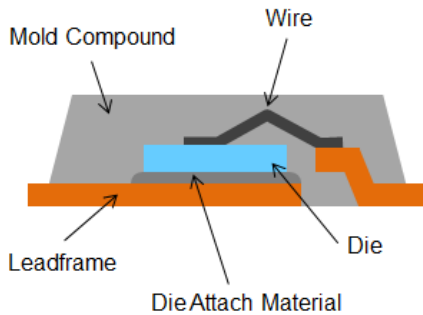
*1 サンプルングテストのみ

HSON8

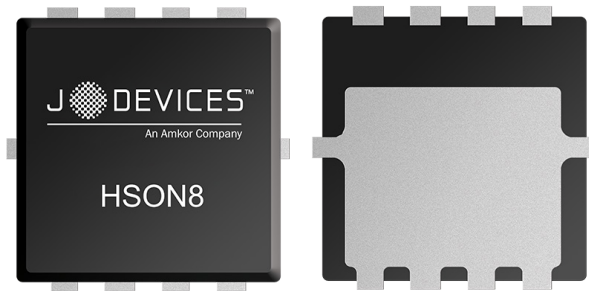
Standard Materials

- ▶ リードフレーム：Cu
(ワイヤボンディング領域にNiめっき)
- ▶ ダイアタッチ：Pbはんだ
- ▶ インターコネクト：Alワイヤー
- ▶ モールド樹脂：ハロゲンフリー

Cross-section



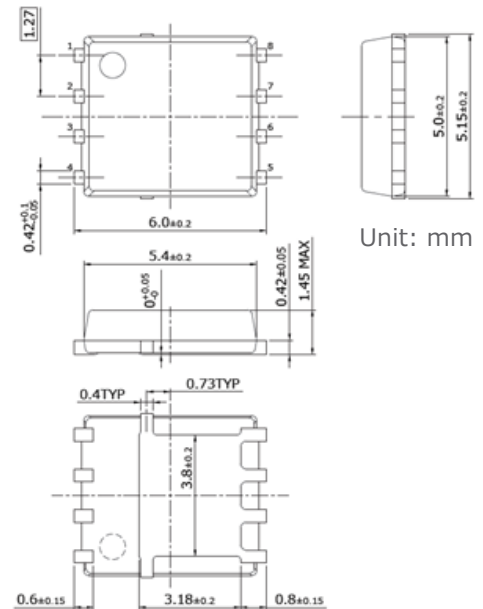
Top & Bottom View



Shipping

- ▶ テープ&リール
 - ▷ 2500 pcs/リール
 - ▷ テープ幅 12 mm
 - ▷ リール Φ = 330 mm
- ▶ バーコードラベル

Package Outline Drawing



詳細についてはamkor.comにアクセス、またはsales@amkor.com までメールをお送りください。

本文中の情報に関して、Amkorは、それが正確であることまたはかかる情報の利用が第三者の知的権利を侵害しないことについて、いかなる保証もいたしません。Amkorは同情報の利用もしくはそれに対する信頼から生じたいかなる性質の損失または損害についても責任を負わないものとし、また本文書によっていかなる特許またはその他のライセンスも許諾しません。本文書は、いかなる形でも販売の標準契約条件の規定を超え、いかなる製品に対しても、Amkorの保証を拡張させ、または変更することはありません。Amkorは通知することなくいつでもその製品および仕様に変更を行う権利を留保します。Amkorの名前とロゴはAmkor Technology, Inc.の登録商標です。記載されている他の全ての商標は、それぞれの会社の財産です。

© 2018 Amkor Technology Incorporated. All Rights Reserved. DSJD407B-JP Rev Date: 10/18